



## **TOWERJAZZ ET SOITEC SIGNENT UN ACCORD POUR PROPOSER UNE PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE DESTINEE AUX IMAGEURS HAUT DE GAMME A ECLAIRAGE FACE ARRIERE**

**Cette collaboration permettra aux concepteurs d'imageurs CMOS "fabless" d'accéder rapidement à une solution clés en main pour des applications industrielles, médicales et automobiles.**

**Le marché des imageurs à éclairage face arrière atteindra 120 millions de dollars en 2013.**

**MIGDAL HA'EMEK, Israël et BERNIN, France, le 2 février 2010** – TowerJazz, premier fondeur mondial spécialisé, et Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et autres substrats innovants utilisés en micro-électronique, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord aux termes duquel les deux partenaires proposeront une solution clés en main d'imageurs CMOS (CMOS Image Sensors - CIS) à éclairage face arrière (Back Side Illumination - BSI) pour des applications industrielles, médicales et automobiles.

*« Le marché des imageurs CMOS BSI, remplaçant la technologie à éclairage face avant (Front Side Illumination - FSI), devrait atteindre 800 millions de dollars en 2013 »* selon Jérôme Baron, analyste de Yole Development. *« Le marché des imageurs BSI sera principalement poussé par les applications telles que les appareils photos numériques et les téléphones portables, mais également par les imageurs de haute performance destinés aux applications médicales, industrielles et automobiles. Nous estimons que le marché haut de gamme des imageurs BSI atteindra les 120 millions de dollars en 2013. »*

L'offre d'imageurs CMOS BSI bénéficiera de l'expertise complète et du leadership en technologie CIS de TowerJazz. Cette offre intégrera les plaques SOI de Soitec ainsi que sa nouvelle technologie de transfert de circuits Smart Stacking™, adaptée au procédé de fabrication de Towerjazz. Soitec est le leader des substrats SOI et des solutions d'empilement de circuits, et TowerJazz est reconnu dans l'industrie pour la performance de ses pixels. Cette collaboration permettra de disposer rapidement d'une solution de fonderie BSI complète pouvant être utilisée de façon transparente par les clients de TowerJazz.

La technologie BSI connaît un succès croissant sur le marché des imageurs. En effet, la résolution est plus élevée, les pixels de plus petites dimensions capturent davantage de lumière, le rendement quantique est supérieur et les performances sont accrues. Cette technologie assure un facteur de remplissage des pixels de 100 %, ce qui maximalise la collecte des photons sans perturbation par les niveaux métalliques. Grâce à cette approche, les imageurs disposent d'une très haute sensibilité à la lumière dans les applications de haut de gamme.

Fabriquées par Soitec avec sa technologie brevetée Smart Cut™, les plaques SOI permettent de produire des imageurs BSI de façon plus fiable en volume. La nouvelle technologie Smart Stacking™ de Soitec offre aux fabricants de circuits intégrés la possibilité d'empiler des plaques contenant des circuits grâce au collage « low-stress » et à l'amincissement de haute précision. Cette technologie est particulièrement intéressante pour obtenir un faible niveau de « crosstalk » et une qualité de pixel supérieure dans les capteurs d'image CMOS BSI, grâce à l'accès à la face arrière des circuits.



« Il s'agit d'une offre technologique unique dans ce domaine et nous serons les premiers à proposer aux clients ce service de fonderie. Les plaques SOI et la technologie de collage Smart Stacking™ de Soitec complètent parfaitement notre technologie leader d'imageurs CMOS », déclare Dr Avi Strum Vice President et General Manager de la division Specialty de TowerJazz. « Notre collaboration donnera naissance à des imageurs de haute performance et permettra aux concepteurs de sociétés "fabless" de créer de nouvelles générations d'imageurs ultra-sensibles pour des applications dans les domaines du cinéma, des appareils photo numériques, des caméras pour l'aérospatial ou le médical, etc. »

« Ce partenariat présente de nombreux avantages pour l'ensemble des concepteurs "fabless" », déclare pour sa part Dr Bernard Aspar, Directeur de la division Tracit de Soitec qui a développé la technologie Smart Stacking™. « Nous sommes persuadés que la remarquable technologie CIS de TowerJazz, combinée à nos substrats SOI et à notre capacité de production Smart Stacking™ sans équivalent, procurera une offre BSI complète et une solution clés en main pour les clients finaux. »

#### À propos de TowerJazz

Regroupés sous le nom de TowerJazz, Tower Semiconductors Ltd (NASDAQ : TSEM, TASE : TSEM), premier fondeur spécialisé, et sa filiale américaine à part entière Jazz Semiconductor, fabriquent des circuits intégrés dont les géométries varient entre 1,0 et 0,13 micron. TowerJazz fournit des outils de conception à la pointe de l'industrie pour réaliser des projets de haute précision complexes, ainsi qu'une large gamme de technologies personnalisables : SiGE (Silicium-Germanium), BiCMOS, à signal mixte et RFCMOS, imageurs CMOS (CIS), gestion de puissance BCD (Bipolaire-CMOS-DMOS), mémoires non volatiles (NVM) et microsystèmes électromécaniques (MEMS). Pour assurer un service client d'envergure internationale, TowerJazz dispose de deux sites de production en Israël et d'un site aux États-Unis, ainsi que de capacités supplémentaires en Chine par le biais de partenariats de production. Informations complémentaires : [www.towerjazz.com](http://www.towerjazz.com).

#### À propos de Soitec

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plateforme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux États-Unis, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour.

Le groupe comporte trois autres divisions : Picogiga International, Tracit Technologies et Concentrix Solar. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie Smart Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. En décembre 2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entrée sur le marché en plein essor de l'industrie solaire en se positionnant sur la chaîne de valeur au niveau du système de production de l'énergie solaire.

Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.fr](http://www.soitec.fr).

*Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.*

**Contact Presse française**  
Muriel Martin, H&B Communication  
+33 (0)1 58 18 32 44  
[m.martin@hbcommunication.fr](mailto:m.martin@hbcommunication.fr)

**Relations Investisseurs**  
Olivier Brice  
+33 (0)4 76 92 93 80  
[olivier.brice@soitec.fr](mailto:olivier.brice@soitec.fr)

**Contact Presse internationale**  
Camille Darnaud-Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43  
[camille.darnaud-dufour@soitec.fr](mailto:camille.darnaud-dufour@soitec.fr)